

【含有化学物質 - 含有判定/総含有量】

No.	物質群 分類No.	物質群	閾値レベルに よる含有判定	
1	SG006	カドミウム/カドミウム化合物	Y	N
2	SG008	六価クロム化合物	Y	N
3	SG014	鉛/鉛化合物	Y	N
4	SG019	水銀及び水銀化合物	Y	N
5	7440-02-0	ニッケル	Y	N
6	56-35-9	トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	Y	N
7	SG035	三置換有機スズ化合物	Y	N
8	SG009	ジブチルスズ化合物(DBT)	Y	N
9	SG010	ジオクチルスズ化合物(DOT)	Y	N
10	1304-56-9	酸化ベリリウム	Y	N
11	SG026	ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類)	Y	N
12	SG027	ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)	Y	N
13	SG004	臭素系難燃剤(BFR)(PBB類、PBDE類およびHBCDDを除く)	Y	N
14	SG036	塩素系難燃剤(CFR)	Y	N
15	SG028	ポリ塩化ビフェニル類(PCB 類)及び特定代替物質	Y	N
16	SG029	ポリ塩化ターフェニル類(PCT 類)	Y	N
17	SG030	ポリ塩化ナフタレン類(塩素数が2以上)	Y	N
18	SG022	過塩素酸塩	Y	N
19	SG023	パーフルオロオクタンスルホン酸塩(PFOS)	Y	N
20	SG012	フッ素系温室効果ガス(HFC、PFC、SF <sub>6</sub> )	Y	N
21	SG001	アスベスト 類	Y	N
22	SG002	一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料	Y	N
23	SG021	オゾン層破壊物質	Y	N
24	SG031	放射性物質	Y	N
25	50-00-0	ホルムアルデヒド	Y	N
26	3846-71-7	2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール	Y	N
27	SG013	ヘキサブROMシクロデカン	Y	N
28	SG034	短鎖型塩化パラフィン類(C10～C13)	Y	N
29	117-81-7	フタル酸ビス2-エチルヘキシル ( DEHP )	Y	N
30	85-68-7	フタル酸ブチルベンジル ( BBP )	Y	N
31	84-74-2	フタル酸ジブチル ( DBP )	Y	N
32	84-69-5	フタル酸ジイソブチル ( DIBP )	Y	N
33	SG025	フタル酸エステル類 グループ2(DIDP,DINP,DNOP)	Y	N
34	624-49-7	ジメチルフマレート(フマル酸ジメチル)	Y	N
35	SG041	フタル酸ジイソデシル(DIDP)	Y	N
36	84-75-3	フタル酸ジ-n-ヘキシル(DnHP)	Y	N

閾値レベルによる含有判定がYesの物質の詳細情報を以下に示します。

【含有化学物質 - 詳細情報】

No.	物質群 分類No.	使用用途・目的	使用部位	最大均質材料 含有率(ppm)	含有化学物質に 関する追記事項
3	SG014	銅合金成分	コネクタ	500	
		ガラス鉛	水晶振動子	410,000	RoHS適用除外コード:7(c)- I
		ガラス鉛	チップ抵抗	500,000	RoHS適用除外コード:7(c)- I
		ガラス鉛	ネットワーク抵抗	550,000	RoHS適用除外コード:7(c)- I
		銅合金成分	同軸コネクタ	37,000	RoHS適用除外コード:6(c)
		ガラス鉛	PAモジュール	550,000	RoHS適用除外コード:7(c)- I
		添加剤	プリント基板	300	
		ハンダボール不純物	DRAM	94	
		銅合金不純物	シールドフレーム	80	
		銅合金不純物	シールドカバー	80	
		樹脂難燃剤	ダイオード	36,000	
		樹脂難燃剤	コネクタ	220,000	
13	SG004	樹脂難燃剤	トランジスタ	36,000	